



TG-A09AB / TG-S09AB

熱伝導封止ゲル

REACH Compliant RoHS Compliant

製品特長

- ・ 良好な熱伝導性
- ・ 硬化後、デバイスを外部の環境影響から保護
- ・ A:B=1:1
- ・ 室温硬化

応用範囲

Electronic Components - 5G, Aerospace, AI, AIoT, AR/VR/MR/XR, Automotive, Consumer Devices, Datacom, Electric Vehicle, Electronic Products, Energy Storage, Industrial, Lighting Equipment, Medical, Military, Netcom, Panel, Power Electronics, Robot, Servers, Smart Home, Telecom, etc.

保管条件

未開封の状態ですべて室温 25°C 以下に 12 ヶ月保存可能。

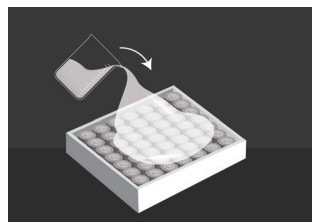
取扱説明書



① Mix component A and B.



② Vacuum out air.

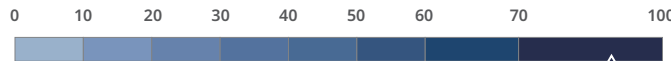
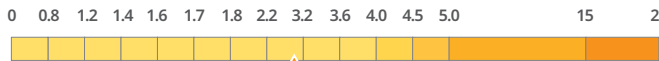


③ Pour potting compound.

製品物性

熱伝導率 : 2.8 W/m·K

硬さ : 90 (Shore OO)



Properties	Unit	TG-A09AB / TG-S09AB	Tolerance	Test Method
熱伝導率	W/m·K	2.8	±10%	ASTM D5470 Modified
色	-	Gray (Mix)	-	-
耐電圧	kV/mm	≥11	-	ASTM D149
体積熱抵抗	Ohm·m	≥10 ¹²	-	ASTMD257
密度	g/cm ³	2.52	±5%	ASTM D792
使用温度範囲	°C	-50~+150	-	-
引張り強さ @3.0mm	kgf/cm ²	230	-	ASTM D412
伸び	%	55	-	ASTM D412
粘性	Pa·s	10~50	-	Brookfield Viscometer
重量減少	%	<1	-	By T-Global
硬化時間 @25° C	hr	6	±10%	-
硬化時間 @50° C	hr	0.6	±10%	-
硬化時間 @80° C	hr	0.08	±10%	-
標準仕様	-	Pot	-	-
硬さ	Shore OO	90	±10	-
混合比	gram	1:1	-	-

▶ A剤とB剤は混合材料で、密度の異なりにより層は成されます。そういう現象は普通ですので、ご安心ください。使用する前にヘラ平型スクレーパーやステンレス製器具でA剤とB剤を別によく混ぜ合わせてください。そうしたら優れた熱伝導効果を作れます。

T-Global Technology 株式会社

Shinagawa Grand Central Tower, 2-16-4 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
 T +81-3-6863-6387 E japan@tglobalcorp.com W www.tglobalcorp.com

Version20
20250325



注意：本技術からのデータ情報はT-Globalからの研究や検査により出てきた最も良い結果です。データ上の数は典型的な数字で、各バッチ製品を検査することではありません。もしスペックが変更されたら、別に通知することはありません。製品の効能に影響を与えられない保護フィルムが剥離紙と保護フィルムは製品の効率に影響を与えられませんが、特別な要望があれば、T-Globalの評価を基準にします。各種の可能な使用条件が弊社のコントロールできる範囲を超えることで、弊社は提出させていただきましたアドバイスは何の保証や責任が生じることがありません。ですので、お客様は製品を試しながら、弊社の製品が各種の条件で応用できるかどうかご確認ください。本製品を売るときには何が特定のところで応用できることを保証することがありません。但し、本製品がT-Globalとお互いに確認したinvoice、お見積りやご注文に基づき、基準的な品質を提供させていただきます。我々は使用者がどのように本技術からのデータ情報を使うことに責任を持ちません。一方、本技術から生み出されたデータ情報は説明内容や製品に関する用途、未来特許衝突、工芸製造や製品の使用についてのアドバイスなどが含まれておりません。